STANDARDLAGENAUFBAU HDI

HDI10_1+8b+1_1,45_17.5

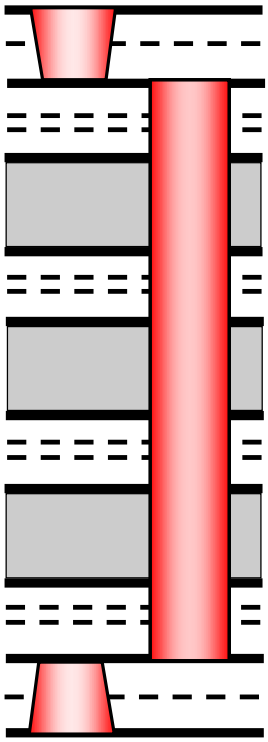
10 - Lagen

Kerne: 0,20 mm Cu 17.5/17.5 µm

WE-Artikel Nr.: **1 + 8B + 1**

KUNDE:

WÜRTH ELEKTRONIK

LAGENBEZEICHNUNG		AUFBAU	BASIS-Material	CU	PREPREG ANZAHL/TYP	ENDDICKE	KUNDEN-FORDERUNG
KUNDE	WE					[µm]	[µm]
1	TOP/VS		Folie	12 µm	1)	12	
					1 x 1080	60	
2	VSK1		Folie	9 µm		30	
					2 x 1080	140	
3	2			17.5 µm		16	
			0,200 mm			200	
4	3			17.5 µm		16	
					2 x 1080	134	
5	4			17.5 µm		16	
			0,200 mm			200	
6	5			17.5 µm		16	
					2 x 1080	134	
7	6			17.5 µm		16	
			0,200 mm			200	
8	7			17.5 µm		16	
					2 x 1080	140	
9	RSK1			9 µm		30	
					1 x 1080	60	
10	BOT/RS		Folie	12 µm	1)	12	
			1) Kupferenddicke Außenlagen ca. 55 µm				
					Gesamtdicke Material:	1448	
			Anmerkung: Werte für Prepreg sind Mittelwerte (der genaue Wert ist von den Leiterbildstrukturen abhängig)				

MATERIALDICKE:	**1,45**	+/-	0,11	mm			Datum:	Bearbeiter:
DICKE über galv. Endoberfläche	1,54	+/-	0,14	mm				
DICKE über LSM incl.galv.-Kupfer	1,60	+/-	0,16	mm				
Kundenforderung:		+/-		mm	Messstelle:			

Erstellt am	von	Geprüft am	von	Freigegeben am	von	Revision	Seite:
27.03.2006	**S. Keller**	04.05.2006	M.Kress	04.05.2006	R.Schönholz	00	13+